

課題番号	研究課題名	研究代表者	評価結果
15106007	チップ間無線通信を用いた高認知度処理システムの三次元集積アーキテクチャ	岩田 穆 (広島大学・大学院先端物質科学研究科・教授)	A
<p>デバイスの微細化のみに依存しない三次元集積技術の構築を目指し、三次元積層チップ間を貫通金属配線ではなく無線通信によって高速で結ぶ技術（チップ間無線インタコネクト）について、基本原理を踏まえ、理論、シミュレーション、実験を行った大変意欲的な研究である。</p> <p>チップ間通信に用いられた無線通信技術自体は従来技術中心のものであるが、三次元集積技術の追求という観点からは本研究は有力候補技術を提案する画期的なものであり、今後の大きな可能性につながるものである。研究内容は堅実であり実用に向けた技術ながら学術的価値も高い。</p>			